

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年8月7日(07.08.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/164585 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/02 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2025/002500

(22) 国際出願日: 2025年1月28日(28.01.2025)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2024-015095 2024年2月2日(02.02.2024) JP

(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 (JP).

(72) 発明者: 中村 隆 央 (NAKAMURA, Takahiro); 〒0600003 北海道札幌市中央区北3条西3丁

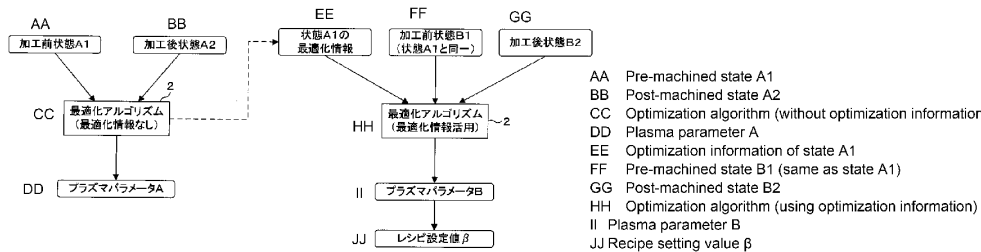
目1 大同生命札幌ビル10階 東京エレクトロン株式会社内 (JP). 川人 大希(KAWAHITO, Daiki); 〒0600003 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1 大同生命札幌ビル10階 東京エレクトロン株式会社内 (JP).

(74) 代理人: 河野 英仁, 外(KOHNO, Hideto et al.); 〒5400035 大阪府大阪市中央区釣鐘町二丁目4番3号 河野特許事務所 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU,

(54) Title: COMPUTER PROGRAM, INFORMATION PROCESSING METHOD, AND INFORMATION PROCESSING DEVICE

(54) 発明の名称: コンピュータプログラム、情報処理方法及び情報処理装置



(57) Abstract: Provided is an information processing method in which parameters related to substrate processing conditions are optimized by using a prediction model that calculates a predicted state after substrate processing on the basis of the initial state of a substrate and the parameters related to substrate processing conditions, wherein: acquired is optimization information that is similar to substrate processing content and is obtained when parameters for machining the substrate from a first pre-machined state to a first post-machined state have been optimized; and the acquired optimization information and the prediction model are used to optimize parameters for machining the substrate from a second pre-machined state to a second post-machined state.

(57) 要約: 基板処理の条件に関連するパラメータ及び基板の初期状態に基づいて基板処理後の予測状態を算出する予測モデルを用いて、基板処理の条件に関連するパラメータを最適化する情報処理方法において、基板処理内容が類似しており、第1加工前状態から第1加工後状態に基板を加工するためのパラメータを最適化した際に得られた最適化情報を取得し、取得した最適化情報及び予測モデルを用いて、第2加工前状態から第2加工後状態に基板を加工するためのパラメータを最適化する。

[続葉有]

LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))